

RESINA EPOXI PARA ENCAPSULADOS

RCL

Descripción

Sistema de dos componentes a base de resinas epoxi, sin solventes.

Aplicación

Encapsulado de circuitos electrónicos y/o elementos eléctricos de baja tensión.

Propiedades

- Excelentes propiedades mecánicas y dieléctricas.
- No presenta contracción alguna.
- Endurece a temperatura ambiente (no menor de 15° C) sin presión. Puede acelerarse mediante aporte de calor.
- Gran adherencia a los materiales encapsulados.
- Resistente a las influencias atmosféricas y químicas.
- Buena flexibilidad interna y gran resistencia al envejecimiento.

Aspecto

Componente A: Pasta tixotrópica de color negro. Pueden suministrarse otros colores a pedido.
 Componente B: Líquido de baja viscosidad.

Relación de mezcla

85:15 en peso.
Para aumentar la flexibilidad del sistema usar la relación 75:25.

Tiempo de empleo

Para 250 g de mezcla:
 20-25° C 2 a 3 horas aprox.

Tiempo mínimo de endurecimiento

20 – 25° C	24 horas
40° C	8 horas
65° C	4 horas

Ambientes muy húmedos a temperaturas normales de curado impiden un endurecimiento total.

Características

Resistencia a la flexión (ISO R 178)	137 kg/cm ²
Dureza (DIN 53456)	14 kg/mm ²
térmica lineal	90-95 X 10 ⁻⁶ mm/° C
Densidad	1,7 g/cm ³
Conductividad térmica	0,5 kcal/mh °C
Rigidez dieléctrica	50 Hz/25° C 210 kV/cm
Factor de pérdidas	50 Hz/25° C (VDE 0303) 0,05
Constante dieléctrica	25° C (VDE 0303) 4,7
Resistividad volumétrica	(VDE 0303) 7 X 10 ¹³ Ω cm
Resistencia a la tracción (ISO R 527)	160 kg/cm ²

Nota: Los valores indicados son aproximados y tomados como promedio de los tests efectuados.

Forma de entrega

Juegos predosificados.

Almacenamiento

En envases cerrados y protegidos de la humedad. En caso de mantener un stock durante tiempo prolongado, recomendamos homogeneizar periódicamente.

Siendo productos químicos, recomendamos tomar las mayores precauciones de higiene en la manipulación de los mismos. Estas informaciones se suministran a título de colaboración, sin que ello implique responsabilidad de nuestra parte.